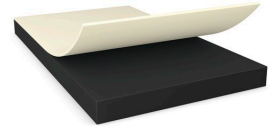




58484

제품 정보



tesa® Low Temperature Reactive (LTR)

제품 설명

tesa® Low Temperature Reactive (LTR 저온 반응성) 58484 제품은 적당한 온도에서 활성화되는 반응성 장착 테이프입니다. 이 블랙 양면 테이프는 무기재료, PE 코팅된 종이 라이너로 보호됩니다.

조립 과정에서 가해지는 적당한 열과 압력에 의해 활성화된다.

특성

- Extremely high bonding performance and reliability, even on slim bonding areas and thin design gaps
- Activated at low temperature and pressure
- Excellent shock resistance
- Sebum resistant
- Very low oozing ratio
- At room temperature tesa® LTR 58484 is not tacky.
- tesa® LTR 58484 is free of halogen and compliant with current RoHS directive.

Applications

tesa® LTR 58484 특히 온도에 민감한 기판의 구조적 접합에 권장됩니다.:

- * Bonding of anodized aluminium
- * Bonding of plastics
- * Mounting of sensitive electronic parts



58484

제품 정보

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	없음	• 총두께	100 µm
• 점착제 종류	저온 활성화 반응 점착제	• 컬러	검정
• 이형지 종류	PE 코팅된 직물		

속성 / 성능 값

• 낮은 VOC	very good	• 점착력 (푸쉬 아웃)	6.5 N/mm ²
----------	-----------	---------------	-----------------------

추가정보

Technical recommendations:

tesa® LTR 58484 is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for bond line parameters to start with.

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, laminate the adhesive tape onto the first component.

Machine setting:

- Temperature¹ 50-60 °C
- Pressure² 1 – 3 bar
- Time 5 – 20 s

Short-time exposure to 60°C bond line temperature during pre-lamination does not impact final bonding potential.

2. Bonding:

Remove the liner from tape after the pre-lamination step.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58484>



58484

제품 정보

추가정보

Position the second component. Apply temperature and pressure for the bonding time to reach sufficient bonding strength.

Setting:

- Temperature¹ 75 – 110 °C
- Pressure² 2 – 5 bar
- Time 10 – 480 s

Short cycle times can be achieved at 110 °C bond line temperature. For activation at lower temperatures, increase the heat-press time or combine a short heat-press step with oven curing.

To reach maximum bonding strength, surfaces should be clean and dry. Allow at least 1-2 hours dwell-time after bonding before performance testing. Final bonding strength will be reached after 24 hours.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions (Material: PC/PC; bonding conditions: temperature (jig) = 90 °C; pressure = 5 bar; time = 120 sec).

Storage:

tesa recommends storage in original packaging in cool and dry conditions.

Low Temperature Reactive should not be exposed to more than 35°C before bonding (during transport, storage and converting).

The shelf life is 15 months after coating date. For the actual shelf life please refer to the best before date on the label in the log roll core.



58484

제품 정보

추가정보

¹ 'Pre-lamination' and 'Bonding' temperature refer to the data that is measured in the bond line.

² 'Pre-lamination' and 'Bonding' pressure refer to the force that is transferred from jig surface directly to the bonding area.

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58484>